



■ 压电微位移快速扫描平台 FSP-315.02.030.CAP



产品特点

- 结构紧凑, 负载能力强
- 多轴同步控制
- 可实现全国产化
- 满足GJB150.16A-2009振动试验
- 满足GJB150.3A-2009高温试验
- 满足GJB150.4A-2009低温试验

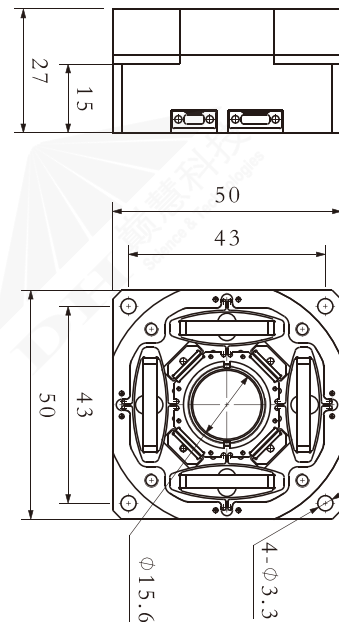
产品用途

- 半导体制造精密定位
- 动态稳像
- 机载成像系统

技术参数

型号	FSP-315.02.030.CAP
通光孔径	Φ15mm
机械行程	≥±30μm
轴数	2 轴
内置传感器	电容传感器
闭环分辨率	≤4nm ^①
空载谐振频率	≥1kHz(±20%)
重复定位精度	≤40nm
线性度	≤0.1%F.S ^②
静电电容	1.92μF/轴 ±20%
外形尺寸	50×50×27mm
质量	≤110g (不含负载)

尺寸图



扫码了解巅慧科技公众号及官网, 获取更多技术参数

注: ①标注的指标为使用16位控制器测试指标 ②标定后线性度